

閎康產學合作計畫作業說明

一、計畫宗旨

閎康科技期望藉由完整且專業的分析檢測技術能量，攜手各大學共同推動新材料、新元件與先進製程之基礎及應用研究，提升國內技術創新與研發能量，培育高階人才，促進產業升級，實現產學合作雙贏。

二、申請與審查

(一) 計畫期程與規模：

自民國110年起，閎康科技每年投入新台幣2,000萬元，補助以高科技產品開發，以及製造、封裝、測試與系統等領域為主題，並結合先進分析檢測技術之前瞻研究計畫。各年度計畫執行期間自當年8月1日起至次年7月31日止。

(二) 辦理公開徵求：

本計畫以國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學、臺北醫學大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、國立中興大學、國立成功大學及國立中山大學等10所大學為合作對象，並透過各校網站、社群媒體、與閎康科技官方網站同步公告計畫徵求資訊。預計每年5月初開始受理申請，並於6月20日截止收件。

(三) 申請人資格與方式：

計畫主持人須具備國科會專題研究計畫主持人資格，並任職於本計畫所列合作單位之內部機構，每人以申請一件計畫為限。申請者須依附件產學合作計畫書格式撰寫申請文件，並於公告截止日期前將電子檔寄送至閎康科技行政窗口；計畫內容相關問題，請洽下列行政或技術窗口。逾期送件、文件不齊全或不符規定者，概不受理。

行政聯絡窗口 邱珮如小姐 -- (03) 611-6678 ext. 3815; JDP@ma-tek.com

技術諮詢窗口 陳弘仁先生 -- (03) 611-6678 ext. 3250; JDP@ma-tek.com

(四) 審查與核定：

計畫申請案由閎康科技統一收件、審查與核定，原則上各合作學校每年預計遴選2至5件計畫。各年度計畫核定結果，最晚將於7月16日前通知計畫申請人。

遴選重點：

1. 研究主題以先進製程、製造封裝、化合物半導體、光電材料、新能源、量子元件、AI晶片、矽光子、奈米生醫等相關領域優先。
2. 計畫內容須具創新性及未來應用發展潛力。
3. 計畫執行期間，建議優先運用閎康科技所提供之分析檢測儀器與相關技術資源。

三、經費補助

本計畫補助金額係依實際運用閎康科技所提供之分析服務項目及數量核定；其測試儀器設備依功能區分為九大領域如下：

1. 非破壞性結構觀察 (3D x-ray, SAT, Thermal EMMI, etc.)
2. 微結構與成份分析 (樣品製備, 高解析 TEM, SEM, FIB, EDS, EBSD, EELS, NBD, SAD, etc.)
3. 雜質濃度檢測 (SIMS, SRP, SCM, XPS, Auger, etc.)
4. 污染與微量檢測 (TOF-SIMS, XPS, FTIR, XRF, etc.)
5. 液態 TEM 分析 (K-kit)
6. 元件級電性量測與缺陷定位 (C-AFM, Nano-probing, EBIC/EBAC, PEM, OBIRCH, Thermal EMMI, etc.)
7. ESD (HBM, MM, CDM, Latch-up, TLP, EOS, etc.)
8. 可靠度測試 (HTOL, HAST, TCT, BLT, TS, Vibration, Shock, H2S corrosion, AMR/AMI, HRTB, etc.)
9. 物理化學分析 (ICP-MS, TGA, LC-MS, etc.)

審查通過之計畫，閎康科技得要求計畫主持人提供詳細之實驗內容與執行步驟，並據以協商補助經費。計畫預算配置比例如下：

- 70%：設備使用費（閎康科技分析儀器）
- 20%：學校管理費
- 10%：人事費、材料費及其他相關業務費用

四、簽約

執行機構依產學計畫相關規定辦理如下：

1. 由雙方確認合約內容（由閎康科技提供，校方進行確認）。
2. 閎康科技（甲方）完成用印後，寄送合約至校方（乙方）辦理用印。
3. 校方（乙方）完成用印後，寄回一份雙方皆用印完成之合約，並同時檢附收據予閎康科技（甲方）。

五、執行

- （一）計畫主持人需至少提供期初計畫、期中進度報告及期末結案報告，並於計畫執行期間可隨時與閎康科技討論研究方法與執行進度。
- （二）閎康科技將為每一計畫配置一位專案人員（PM），負責計畫之收送件聯繫及技術討論等相關事宜。